

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

沪士电子股份有限公司 投资者活动记录表

编号：2025-0923-026

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他：_____
参与单位名称	JP Morgan Asset Management (参会者已签署书面调研承诺函，在交流活动中，我公司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。下文会议纪要中的内容不代表公司对未来的盈利预测和业绩指引，请投资者注意投资风险并谨慎投资。)
时间	2025年9月23日 15:00-16:15
地点	公司会议室
形式	实地调研
公司接待 人员姓名	钱元君、王术梅
投资者关系活动 主要内容介绍	1、公司整体经营策略 公司差异化经营，将技术能力、制程能力、产能结构动态适配市场中长期的需求结构，坚持面向整体市场的主要头部客户群体开展业务。公司向来注重中长期的可持续利益，而非仅仅局限于眼前的短期利益。公司深知只有着眼长远，保持客户均衡，才能在不断变化的市场环境中稳健发展，实现可持续增长。 面向整体市场的主要头部客户群体开展业务，对公司的综合竞争力提出了更高要求，这意味着公司不仅要配备完善的工具包，还要持续打磨综合制程能力与技术能力。公司需要准确把握未来的产品与技术方向，在超高密度集成、超高速信号传输等方面持续加大技术和创新方面的资源投入，通过技术创新、均衡的多元化客户结构、供应链韧性及区域布局，在复杂的市场环境中保持韧性和竞争优势，在不确定中锚定确定性。

2、企业通讯市场板业务收入情况

2025年上半年，受益于人工智能和高速网络基础设施的强劲需求，公司企业通讯市场板实现营业收入约65.32亿元，同比大幅增长约70.63%，其中AI服务器和HPC相关PCB产品同比增长约25.34%，占公司企业通讯市场板营业收入的比重约23.13%。高速网络的交换机及其配套路由相关PCB产品成为公司增长最快的细分领域，同比增长约161.46%，占公司企业通讯市场板营业收入的比重约53.00%。

3、资本开支及市场情况

AI驱动的服务器、数据存储和高速网络基础设施需求增长以及新兴应用领域的拓展为行业带来发展机遇，公司近两年加快资本开支，2025年上半年财报现金流量表中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金约13.88亿。除了连续实施技改扩容外，公司在2024年Q4规划投资约43亿新建人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目已于2025年6月下旬开工建设，预期将在2026年下半年开始试产并逐步提升产能。该项目的实施能进一步扩大公司的高端产品产能，并更好的配合满足客户对高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对高端印制电路板的中长期需求，增强公司核心竞争力，提高公司经济效益。

从中长期看，人工智能和网络基础设施的发展需要更复杂、更高性能的PCB产品，以支持其复杂的计算和数据处理需求，为PCB市场带来新的增长机遇，同时也对PCB企业的技术能力和创新能力提出了更高的挑战。更多的同行也纷纷将资源向该领域倾斜，试图进入该领域并取得一定的市场份额，未来的竞争势必会加剧。公司需要准确把握战略节奏，适度加快投资的步伐，通过深入分析市场趋势和自身发展需求，合理配置资源，将更多的资金投入到具有潜力和创新的领域，不断进行技术升级和创新，开发更高密度的互连技术、更高速的传输性能等，提高产品的竞争力，并快速响应市场需求，从而抢占市场先机，筑牢并拓展“根据地”业务，实现可持续发展。

4、泰国工厂

沪士泰国生产基地于2025年第二季度进入小规模量产阶段，在AI服务器和交换机等应用领域，已陆续取得客户的正式认可。沪士泰国生产基地的顺利运营是公司海外战略布局的关键支撑，公司正全力提升其生产效率和产品质量，随着客户拓展及产品导入的逐步推进，其产能将逐步有序释放，并进一步

	验证其中高端产品的生产能力，为产品梯次结构的优化升级奠定基础，预期2025年末可接近合理经济规模，为后续经营性盈利目标的实现筑牢根基。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
附件清单	无